



平成 28 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第 1 部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之
(TEL 093-614-1111)

平成 28 年 (2016 年) 熊本地震の影響に関するお知らせ (続報)

この度の熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

また、今回の被災に関しましては、各方面よりお見舞いや励ましのお言葉、多大なるご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社グループにおける地震の影響について、平成 28 年 4 月 18 日付で公表しておりましたが、その後の状況、損失の概要について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 被災した拠点

株式会社三井ハイテック 熊本事業所	生産品目：IC 組立
株式会社三井電器	生産品目：IC リードフレーム

2. その後の状況

サプライチェーンへの影響を最小限とすべく当社の福岡県内の事業所で IC リードフレームの代替生産等に取り組むとともに、当社グループの総力を結集し復旧活動を急ピッチで進め、生産再開に取り組んだ結果、5 月末に両工場ともに復旧いたしました。

3. 損失の概要

今回の被災により工場建屋および設備の一部等が被害を受け、平成 29 年 1 月期 第 1 四半期においては、特別損失として熊本地震に係る「災害による損失」2 億 7 千 3 百万円を計上しております。

なお、今後、業績に著しい影響がある場合には速やかにお知らせいたします。

以 上